Proceedings of the 24th Linear Accelerator Meeting in Japan (July 7-9, 1999, Sapporo, Japan)

[P7-36]

THE HOUSE FABRICATION ON L-BAND SUPERCONDUCTING 3CELL CAVITY AT SHI

Y. Matsubara, M. Hirose, T. Hori, H. Saito*, F. Yukawa** H. Inoue***, M. Ono***, E. Kako***, S. Nogichi***, K. Saito***, T. Shishido***

Research and Development Center, Sumitomo Heavy Industries, Ltd. (SHI) 2-1-1, Yato-Cho, Tanashi-City, Tokyo 188-8585 Japan *Quantum Equipment Business Center, Sumitomo Heavy Industries, Ltd. (SHI) 5-2, Soubiraki-Cho, Niihama-City, Ehime-Ken, 792-8588 Japan **Sumiju Technical Center Co., Ltd. (STC).

1-2, Kuryoutsutsumi, Hiratsuka-City, Kanagawa-Ken, 254-0801 Japan

***High Energy Accelerator Research Organization (KEK)

1-1, Oho, Tukuba-City, Ibaraki-Ken, 305-0801 Japan

ABSTRACT

We have investigated the effect of removal thickness with electropolishing (EP) using our first fabricated L-band bulk-niobium single cell cavity (SHI-1). We obtained finally the maximum accelerating field (max Eacc) of 32 MV/m, by the removed thickness of 150 μ m, which included 20 μ m light chemical polishing (CP) and 750°C annealing. With this result, we have fabricated a second single cell cavity (SHI-3) applying 130 μ m CP and 30 μ m EP on the cavity. And, the cavity was not annealed because of checking Q-degradation. We could not obtain a good performance (the max Eacc was 7.3MV/m) due to bad welding condition on equator section. However, the cavity without annealing gave us the result where Q-degradation was not observed. Next, we fabricated a 3-cell cavity with the same welding condition on SHI-3. In this paper, we report on the result, 3-cell cavity design and performance.

L-バンド超伝導 3連加速空洞の製作

1はじめに

高エネルギー加速器研究機構(KEK)の指導の もと、超伝導キャビティーの開発に携わってから2 年の時が経過しました。

現在まで、Lバンドのシングルセル空洞を4台、 3連空洞を1台製作しました。第一号機(無名)は、 ハンドリング技術の研究のためにCopper 製のモデ ル空洞を製作しました。第二号機として、Nb製空 洞(SHI-1)をKEKにて製作していただきました。 SHI-1空洞では、主に電解研磨(EP)による研磨 量と加速電界の関係が調べられました[1]。結果と して、150μm研磨後、目標とする30MV/m以上の 加速電界を得ることができました。

SHI-1の調査と同時に第三号機(SHI-2)の製作が 行われました。これは、電子ビーム溶接機の溶接条 件の調査を目的に製作されました。

第4号機(SHI-3)は、SHI-2の結果を用いて製作 されたNb製のシングルセル空洞です。SHI-3の表 面処理は表面研磨速度の速い化学研磨(CP)を初 期研磨法として選び、最終処理としてEPを用いて 150μmまで一気に研磨を施すことにしました。こ の処理の過程で水素脱ガスアニールの工程を省き、 CP処理で発生する水素病[2]について調べるこ とにしました。得られた加速電界は7.3MV/mと極め て低いものの、初期研磨として多量CP処理(130 μm)を用いたにも関わらず水素病は観察されませ んでした。

第五号機(SHI-4)は、3連のNb製空洞でありま す。この空洞の製作において、マルチセル超伝導空 洞の製作工程及び製作時間を減らす工夫することに チャレンジしました。

2 3連空洞の設計

3 連空洞の形状決定には2次元電磁場解析コード SUPERFISHを用いました。得られた結果をTable.-1 に形状をFig.-1に記します。

Table 1:シングル空洞と3連空洞の解析値

(材質:C u)	シングル空洞	3 連空洞		
周波数(MHz)	1295.048824	1298.842285		
Q 値	28461	29241		
シャントインピ [。] ーダンス(Ω)	3.133×10 ⁰	9.276×10 ⁰		
R/Q (Ω)	110.08	317.14		
G(形状因子) (Ω)	265.3	274.9		
Ep/Eacc	1.91	2.630		
Hp/Eacc (Oe/MV/m)	43.36	43.57		



Fig.13連空洞の設計値、Iris部に発生したブロー ホール位置及び、溶接前後の寸法差

3 3連空洞の製作

3連空洞の製作においては一つの主眼を設定しま した。量産を頭におき、電子ビーム溶接機の真空 チャンバー中に置かれた3連空洞の4個所のアイリス 部を真空チャンバーの真空を一度も破らずに実施す ることを試みました。このとき、SHI-2において得 た結果を3連空洞に適用しました。



Fig.-2 M断面に発生したブローホール

しかしながら、溶接の結果はFig.-1に示される断面K,L,Mにブローホールが発生しました。特にM断面は、ひどくFig.-2に示すような結果となりました。 Fig.-1のM断面は、最終の溶接場所であったため他のアイリスよりも初期温度がかなり高かったと想定できます。その他の部分の溶接部の内面をFig.-3 に示します。



a) b) Fig.-3 製作された3 連空洞の溶接ビード a) 赤道部溶接ビード(電子ビーム照射側) b)Iris部溶接ビード(N断面:電子ビーム透過側)

アイリスにあいた穴を、KEKにて修復していた だきました。穴の部分に化学研磨をして洗浄した Nbのパッチを埋め込み溶接しました。

SHI-2でわれわれが得たアイリス部の溶接縮代は 1mmです。その縮代を考慮して溶接を行いました が、ブローホール部の修復を含め最終的に得られた セル間のギャップ長さは設計値よりそれぞれ2mm づつ長くなりました(Fig. -1参照)。

ビーズ法を用いて測定された、3連空洞の中心軸 上での電界分布をFig.-4に示します。計算値 に比べセル間ギャップが2mm長い影響が現れまし たが、各セルの電界強度が5%以内と小さかったた め、チューニングは実施しませんでした。





Table.-2 3連空洞の共鳴周波数とセル間カップリ ング係数 κ

Mode	DESIGN VALUE (MHz)	300K before chemistry (MHz)	4.2K after 1st chemistry (MHz)
π	1298.842	1296.535	1298.562
2π/3	1288.387	1286.160	1288.187
π/3	1269.532	1268.525	1269.378
κ	3.109	3.000	3.095

また、得られた周波数より、セル間の結合係数 Table.-2に示します。

4 空洞の表面処理と性能評価

これまでの試験で30MV/m以上の加速電界を得る ための必要研磨量は150μmであることがわかって います。

SHI-3空洞ではC.P 130µm、E.P 30µmがおこな われましたが赤道溶接部の不具合(ハーフセルの合 わせ面がずれていたため、約1mmの段差ができて いた)が確認されていたため、この表面処理の組合 わせの評価ができていませんでした。この処理の再 確認も含め、3連空洞ではCPを初期研磨に使用し、 仕上げにEPを使用することにしました。

これまでに、2度の表面処理と性能評価が行われ ました。表面処理の過程をTable.-3に、性能評価 の結果をFig.-5に記します。表面処理の過程におい てSHI-3空洞と同様に水素脱ガスアニールは実施し ていません。

Table3 3	運空洞に	用いら	れた表	面処理
-----------------	------	-----	-----	-----

Chemistry No.	CP (μ m)	$\begin{bmatrix} \mathbf{EP} \\ (\mu \mathbf{m}) \end{bmatrix}$	HPR (hr.)	COMENTS
1	100	30	1.5	
2		30	3.0	After 1st chemistry

*CP :横形回転方式を採用

**HPR:純水を用いた高圧ジェット水洗



Fig.-5 3連空洞におけるQo-Eacc curve

第一回目の測定で得られた最大加速電界は 15.8MV/mでありました。9MV/mからはX-線を伴 い、フィールドエミッションによりクエンチに至っ たと考えられます。フィールドエミッションが発生 した要因を以下列挙します。

- □ 高圧水洗を、シングルセルとほぼ同じ時間 (90分)で実施した(洗浄不足)。
- □ 高圧水洗後、空洞内部の真空排気中に真空排 気システムが一時停止し、10⁻³torrまで真

空が悪化した。

□ E.P実施時に、熱交換器のトラブルにより電解 液の温度が通常よりも高くなっていた。

第二回目の測定ではこれらの要因をできるだけ取り 除くように注意しました。結果は、15MV/mからマ ルチパクタリングが発生し19MV/mで中間状態に陥 りました。

通常シングルセル空洞においても、同じような電 界域においてマルチパクタリングが発生します。そ して、RFプロセッシングにより加速電界が増加し ていきます。今回は、一時間以上のRFプロセッシ ングを実施しても、それ以上の電界の増加が見られ ませんでした。

5まとめ

量産を考慮した3連空洞の製作及び処理を実施し ました。製作においてアイリス部にブローホールが 多数発生するなどの失敗がありましたが、製作され た3連空洞はチューニングをせずに必要な電界分布 が得られました。また、性能測定においては加速電 界19MV/mを得ることができました。

謝辞

表面処理にあたり、さまざまな注文をうけいれて いただいた野村鍍金(株)のみなさまに感謝いたしま す。また、3連空洞の製作進行にあたり、各ステッ プにおいて助言をいただいたKEK L-バンドグルー プの皆様に感謝いたします。

参考文献

- Y.Matsubara et al."THE PRESENT STATUS OF DEVELOPMENT ON SUPERCONDUCTING CAVITIES AT SHI" Proc.19th International LINAC Conference.
- [2] K.SAITO and P.Kneisel "Qo-degradation Due to Hydrogen in High Pure Niobium Cavities" Proc. 18th Linear Accelerator Meeting in Japan, 1993.
- [3] Y.Matsubara et al. "THE HOUSE FABRICATION ON SUPERCONDUCTING CAVITIES AT SHI"

1st Superconducting Linear Accelerator Meeting in Japan, 1998.